

惠州中京电子科技股份有限公司

2023 年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

2、预计的业绩： 亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损：11,000万元-12,000万元	亏损：17,909.49万元
	比上年同期减亏：33.00%-38.58%	
扣除非经常性损益后的净利润	亏损：12,800万元-13,800万元	亏损：21,258.29万元
	比上年同期减亏：35.08%-39.79%	
基本每股收益	亏损：0.18元/股 - 0.20元/股	亏损：0.30元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。公司已就本次业绩预告与年报审计会计师事务所进行了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧，具体数据以审计结果为准。

三、业绩变动原因说明

本报告期业绩变动主要系：

1、报告期内，受行业结构性需求减弱等外部不利环境影响，订单量及订单

价格出现下滑，2023 年度公司实现营业收入约 26.30 亿元，同比上年有所下降。另公司子公司珠海中京富山新工厂销售收入与产品结构尚未达成规划目标，新工厂设备折旧及公共摊提等固定费用较高，报告期内珠海中京及公司仍处于亏损状态。但是公司通过积极优化产品结构，持续施行降本增效政策并取得明显效果，使得亏损同比较大幅减少。

2、报告期内，公司继续增强在新型显示(MiniLED&OLED)、新能源汽车电子等应用领域的竞争优势，积极扩大在新能源汽车动力和储能电池 BMS 用 FPC 应用模组、刚柔结合板 R-F 等产品的技术改造和项目投资；公司有序开展集成电路(IC)封装载板项目的研究投入，卓有成效地进行了相关半导体客户开发并实现中小批量销售。随着公司新产品、新客户开发与投入的持续加强，IC 封装载板项目的量产及珠海富山新工厂“3S”类等高端产能的陆续释放，预计将为公司未来竞争力提升、盈利能力改善和企业发展注入活力。

四、风险提示

本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经注册会计师审计，具体财务数据公司将在 2023 年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

惠州中京电子科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 12 日